

中电科芯片技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司战略实施，加强公司法人治理结构，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年度，半导体行业下行压力持续增大，公司所处消费电子和安全电子市场压力增加，公司聚焦优势领域、紧抓重点市场，在卫星通信与导航、蜂窝与短距通信、安全电子、能源管理、消费电子、智能电源、智能网联汽车等应用领域积极开拓市场，公司产品结构不断优化，业务持续发展，行业地位、核心竞争力不断提升。

（一）经营情况

报告期内，公司主营业务保持不变，为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。2024 年，安全电子市场总体需求释放滞后价格下跌，消费电子市场需求低迷，尤其外销出口市场订单萎缩，导致消费电子类产品销售收入下滑。公司积极调整经营策略，持续加强研发投入和产品迭代升级，积极丰富公司产品谱系，在卫星通信与导航、安全电子及智能网联汽车等领域实现产品与技术突破，公司核心竞争力稳步提升。公司 2024 年实现营业收入 10.45 亿元，同比下降 31.47%，产品毛利率为 29.86%，较上年同期 30.52%下降 0.66 个百分点；其他收益较上年同期下降 9.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.69 亿元，同比下降 70.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.36 亿元，同比下降 81.76%。

（二）市场拓展情况

在卫星通信与导航、蜂窝与短距通信、安全电子、能源管理、消费电子、智能电源、智能网联汽车等细分领域，公司充分利用硅基模拟工艺高集成度、多功能、多通道、数模混合可重构等特点，截至 2024 年末累计形成上千款系列化、方案化、集成化的单片和模块产品，并为终端客户提供整体解决方案，通过技术创新和产业链布局，不断提高产品性价比，进入更多头部客户和优质客户供应链。

（三）研发情况

报告期内，公司专注核心技术积累与新产品开发，坚持保障研发投入，推动公司技术突破及产品迭代升级。全年研发累计投入 2.18 亿元，占营业收入比例为 20.82%，较上年同期 13.54%增加 7.28 个百分点。截至 2024 年末，公司累计获得授权专利 161 项（其中发明专利 87 项、实用新型专利 64 项、外观专利 10 项），集成电路布图登记 98 项，软件著作权 15 项；公司申请受理专利 72 项。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司第十二届董事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》的相关规定开展换届选举工作。2024 年 8 月，选举产生第十三届董事会成员，聘任新一届高级管理人员。

2024 年，公司召开董事会 7 次，共计审议 50 项议案，详细情况如下：

1.2024 年 3 月 29 日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2.2024 年 4 月 24 日，公司召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过：

- (1)《2023 年度董事会工作报告》；
- (2)《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
- (3)《2023 年度独立董事述职报告》；
- (4)《2023 年度总经理工作报告》；

- (5)《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
- (6)《关于会计政策变更的议案》；
- (7)《关于审议 2023 年度相关审计报告的议案》；
- (8)《2023 年年度报告及摘要》；
- (9)《2024 年第一季度报告》；
- (10)《2023 年度内部控制评价报告》；
- (11)《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》；
- (12)《2023 年度利润分配方案》；
- (13)《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》；
- (14)《关于重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》；
- (15)《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
- (16)《关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》；
- (17)《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (18)《2023 年度 ESG 暨社会责任报告》；
- (19)《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；
- (20)《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；
- (21)《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估的报告》；
- (22)《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》；
- (23)《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
- (24)《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
- (25)《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- (26)《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3.2024 年 8 月 8 日，公司召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过：

- (1)《2024 年半年度报告及摘要》；
- (2)《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (3)《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；
- (4)《关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (5)《关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》；
- (6)《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

4.2024 年 8 月 26 日，公司召开第十三届董事会第一次会议，审议通过：

- (1)《关于选举第十三届董事会董事长、副董事长的议案》；
- (2)《关于选举第十三届董事会专门委员会成员及召集人的议案》；
- (3)《关于聘任总经理的议案》；
- (4)《关于聘任副总经理的议案》；
- (5)《关于聘任财务总监的议案》；
- (6)《关于聘任董事会秘书的议案》。

5.2024 年 10 月 28 日，公司召开第十三届董事会第二次会议，审议通过：

- (1)《关于变更 2024 年度审计机构的议案》；
- (2)《关于部分募投项目延期的议案》；
- (3)《2024 年第三季度报告》；
- (4)《关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (5)《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
- (6)《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》；
- (7)《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

6.2024 年 12 月 11 日，公司召开第十三届董事会第三次会议，审议通过：

- (1)《关于增补第十三届董事会非独立董事的议案》；

(2)《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

7.2024 年 12 月 27 日，公司召开第十三届董事会第四次会议，审议通过：

(1)《关于选举董事长的议案》；

(2)《关于调整第十三届董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。

(二) 董事会各专门委员会会议召开情况

董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供良好支持。其中：董事会审计委员会召开会议 6 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次、战略委员会召开会议 1 次、提名委员会召开会议 3 次。

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事根据相关法律法规的要求和公司内部制度的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议拟提交董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，报告期内共召开 3 次独立董事专门会议，充分发挥独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

三、股东大会召开情况及董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行信息披露义务。全年召开 5 次股东大会，审议 19 项议案，详细情况如下：

(一) 2024 年 4 月 15 日，召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补第十二届监事会非职工监事的议案》。

(二) 2024 年 5 月 27 日，召开 2023 年年度股东大会，审议通过：

(1)《2023 年度董事会工作报告》；

(2)《2023 年度监事会工作报告》；

(3)《2023 年度独立董事述职报告》；

(4)《2023 年年度报告及摘要》；

(5)《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》；

(6)《2023 年度利润分配方案》；

(7)《关于重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》；

(8)《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

(9)《关于预计公司及控股子公司 2024 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》；

(10)《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

(三) 2024 年 8 月 26 日，召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过：

(1)《关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》；

(2)《关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》；

(3)《关于监事会换届及提名第十三届监事会非职工监事候选人的议案》。

(四) 2024 年 11 月 14 日，召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过：

(1)《关于变更 2024 年度审计机构的议案》；

(2)《关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

(3)《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

(4)《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》。

(五) 2024 年 12 月 27 日，召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于增补第十三届董事会非独立董事的议案》。

四、信息披露情况

为保证投资者对公司重要信息获取的及时、准确、完整，董事会实时关注公司各类重大事项的发生和进展，严格按照上海证券交易所信息披露的相关要求公平、公正、公开地进行信息披露，2024 年度披露公告文件 118 份，其中公告 63 份，定期报告 4 份、非公告编号文件 51 份。公司通过投资者咨询电话、电子邮箱、业绩说明会、上证 E 互动平台、参加重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等方式，加强与投资者的沟通交流。

公司重视防范内幕交易，严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，对内幕信息知情人登记备案，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情

人员在信息披露前严格执行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

五、发展战略

公司聚焦硅基半导体元器件主业，致力于为国家数字产业化、产业数字化发展提供自主化产业基础支撑。公司将瞄准信号链（信号接收/信号转换/数字预处理）、功率链（电源/电源管理）、驱控链（信号驱动/控制）模拟及数模混合集成电路专业领域，以市场需求为导向，以技术创新为动力，持续完善市场、技术和产业链布局，强化内外部资源协同整合，丰富产品矩阵，形成以多技术融合体系为基础的新质生产力，打造具有核心竞争力的一流半导体领航企业。

六、2025 年度董事会工作计划

（一）强化战略引领，指导市场和技术发展

2025 年，公司董事会将充分发挥下属战略委员会职能，推动公司确立更加清晰的企业愿景与战略目标，坚持自主创新、特色发展路径，重点强化核心竞争力建设。公司董事会将推动公司做实规划，以战略规划引领公司高质量发展。聚焦主责主业，明确业务布局和产品发展路径。瞄准国家重大需求和经济主战场，未来三年主要面向国家安全及国计民生的重点领域以及战略新兴产业，重点关注商业航天、低空经济、机器人、6G 通信等领域。

（二）完善制度体系建设，筑牢公司风险管控根基

2025 年，公司董事会将充分发挥下属审计委员会职能，紧跟法律法规与监管政策更新步伐，根据新《公司法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引》等法律法规，推动公司全面修订《公司章程》和内部控制制度，不断完善法人治理、合规风控、安全生产等公司管理体系建设，聚焦治理结构优化与合规能力提升。强化主动风险防控意识，提升风险管理的预见性、精准度与有效性。

2025 年，公司董事会将持续督促公司强化财务管理效能，从源头把控客户信用风险，坚持独立风险评估与项目风险定价原则，科学评估项目风险与收益，确保风险可控、收益可期。在确保风险可控的基础上，推动公司各业务板块紧跟市场需求变化，动态分析政策导向与行业趋势，灵活调整战略方向，加速产品结构调整与转型升级步伐，以适应市场变革与行业转型需求，促进公司运营质量和效能稳健提升。

（三）深化产业协同，加快市场和产品创新

2025 年，公司董事会将积极推动公司业务深度融合与内外产业链协同发展，深化市场营销差异化策略，拓宽客户群体，实现与客户的共赢成长，不断夯实改善基本面。同时，注重科技研发投入及成果转化，持续推动创新。

2025 年，公司董事会将督促公司在充分分析市场和客户情况的基础上，一方面深度挖掘老产品新市场、老产品新客户、老客户新市场，提供持续增长动力；另一方面重点培育和紧跟新的行业龙头客户，在新领域获得有效的需求牵引。推动公司聚焦核心技术突破，提升自主创新能力。结合市场和产品布局，开发具有一定护城河的中高端芯片，加大高端芯片研发投入，重点突破射频、模拟、数模混合芯片中的“卡脖子”技术，实现从“跟随者”到“引领者”的转型。

（四）加快人才体系建设，夯实公司发展根基

2025 年，公司董事会将充分发挥下属薪酬与考核委员会和提名委员会职能，积极推动公司人才梯队建设力度，培育积极向上的企业文化，积极履行社会责任，优化人力资源配置，加强核心骨干培养，为公司长远发展奠定坚实的人才基础。

2025 年，公司董事会将根据既定的发展战略和经营目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强专门委员会的各项职能，聚焦主责主业，全面提升管理水平，加大科技创新和研发力度，拓展产品应用领域，开拓新兴市场，提升综合竞争力，为实现年度经营目标提供有力的决策支持和保障，坚定不移推动公司高质量发展。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日